

***Judul:***

Peningkatan kualitas pada proses moulding dengan menggunakan metode response surface untuk mengurangi problem wire sweep = Quality improvement on moulding process by using response surface method for decreasing wire sweep problem

***Pengarang/Penulis:***

Isprianti, author

***Subjek:***

Molding (Chemical technology)

***Nomor Panggil:***

S44733

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)